



Creating the Future with Adhesive Technologies

Linkage + Technology

LINTEC

夢をカタチにする粘・接着技術のリンテック

会社概要

本 社	東京都板橋区
証券コード	7 9 6 6 (東証1部)
設 立	1 9 3 4年(昭和9年) 1 0月1 5日
資本金	2 3 2億円(1 1年3月末)
従業員数	4,1 9 8人(1 1年3月末):連結
売上高	2,1 2 7億円(1 1年3月期):連結
決算日	3月3 1日
事業内容	粘着製品、粘着関連機器、特殊紙、 剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売
事業拠点	国内連結子会社: 4社 海外連結子会社: 19社



1934年
(昭和9年)

ガムテープメーカー「不二紙工株式会社」
設立(東京・板橋)



1960年
(昭和35年)

シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムの
製造・販売を開始

以降、屋内外装飾、二輪・自動車関連などの
工業分野に粘着事業を拡大

1984年
(昭和59年)

UV硬化型ダイシングテープを開発し、
半導体関連分野に本格参入



1987年
(昭和62年)

米国のマディコ社を子会社化

1990年
(平成2年)

四国製紙、創研化工と合併
「リンテック株式会社」に商号変更

特殊紙、剥離紙・剥離フィルムから粘着紙・
粘着フィルム、関連機器分野にまで業容を拡大



1991年
(平成3年) 液晶関連分野に本格参入

1993年
(平成5年) 琳得科(天津)実業有限公司を設立

1994年
(平成6年) リンテック・インドネシア社を設立

2000年
(平成12年) リンテック・インダストリーズ(マレーシア)社を設立

2002年
(平成14年) 琳得科(蘇州)科技有限公司を設立

リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(韓国)社を設立

2003年
(平成15年) リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(台湾)社を設立

2004年
(平成16年) リンテック・コリア社を設立

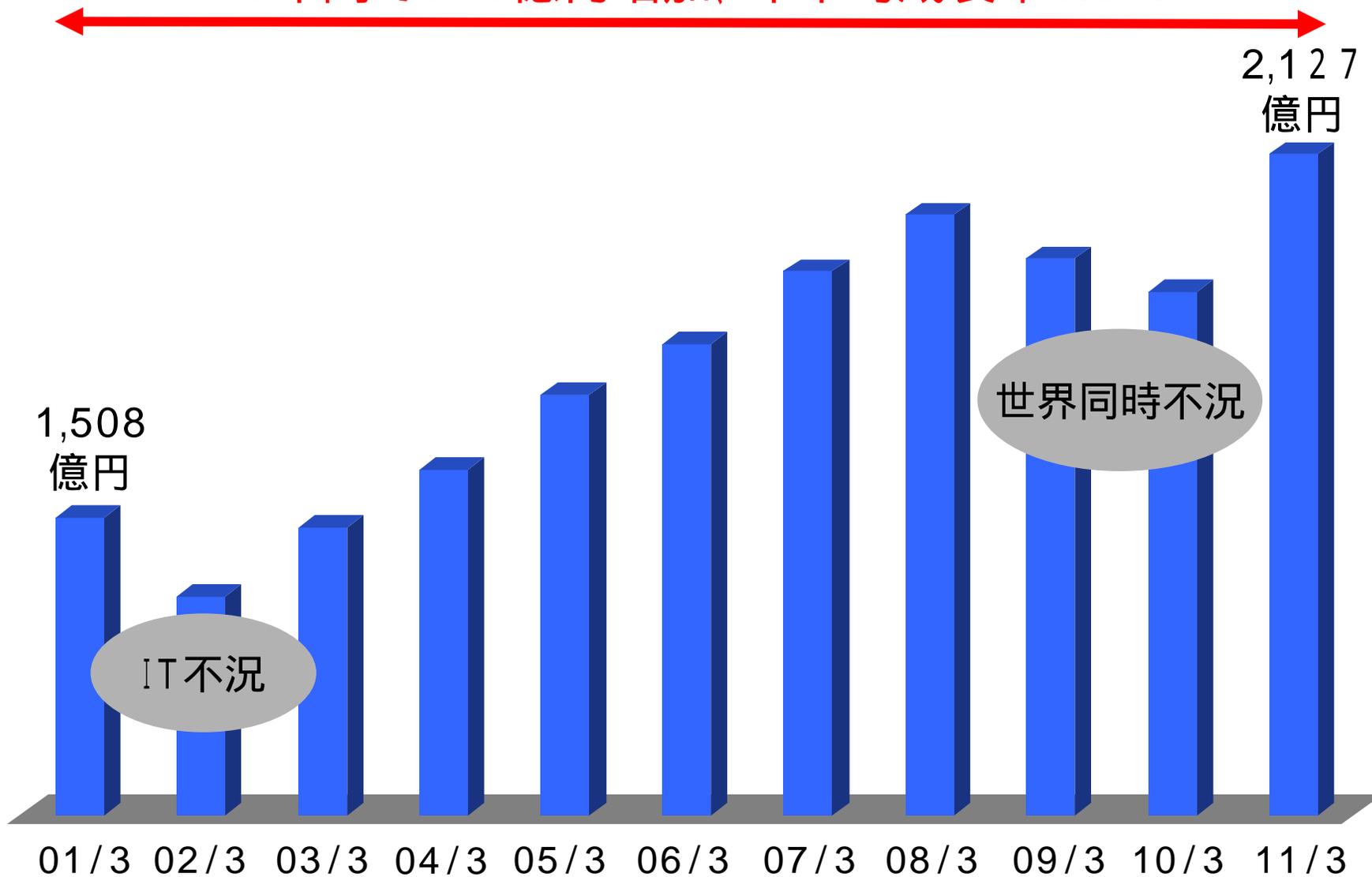
2011年
(平成23年) リンテック(タイランド)社を設立

2012年7月稼働予定



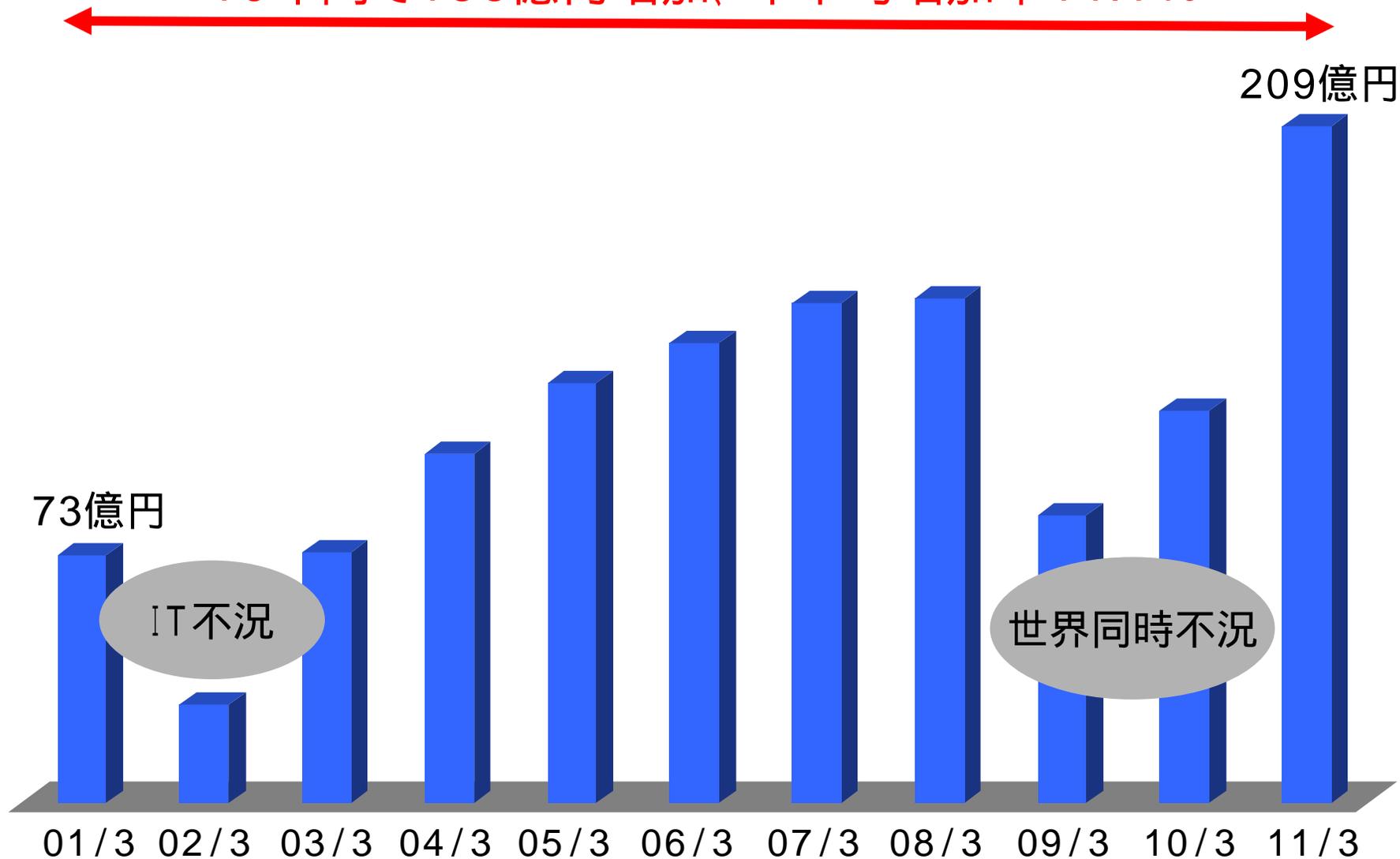
業績推移 / 売上高

10年間で619億円増加、年平均成長率3.5%

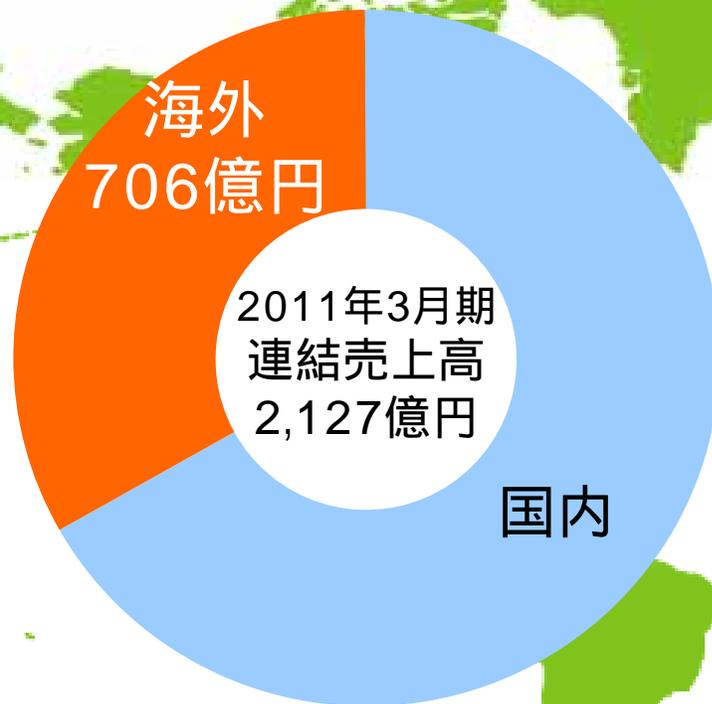


業績の推移 / 営業利益

10年間で136億円増加、年平均増加率11.1%



10年間で510億円増加、年平均成長率13.7%
(特にアジア地域売上高の年平均成長率は18.2%)

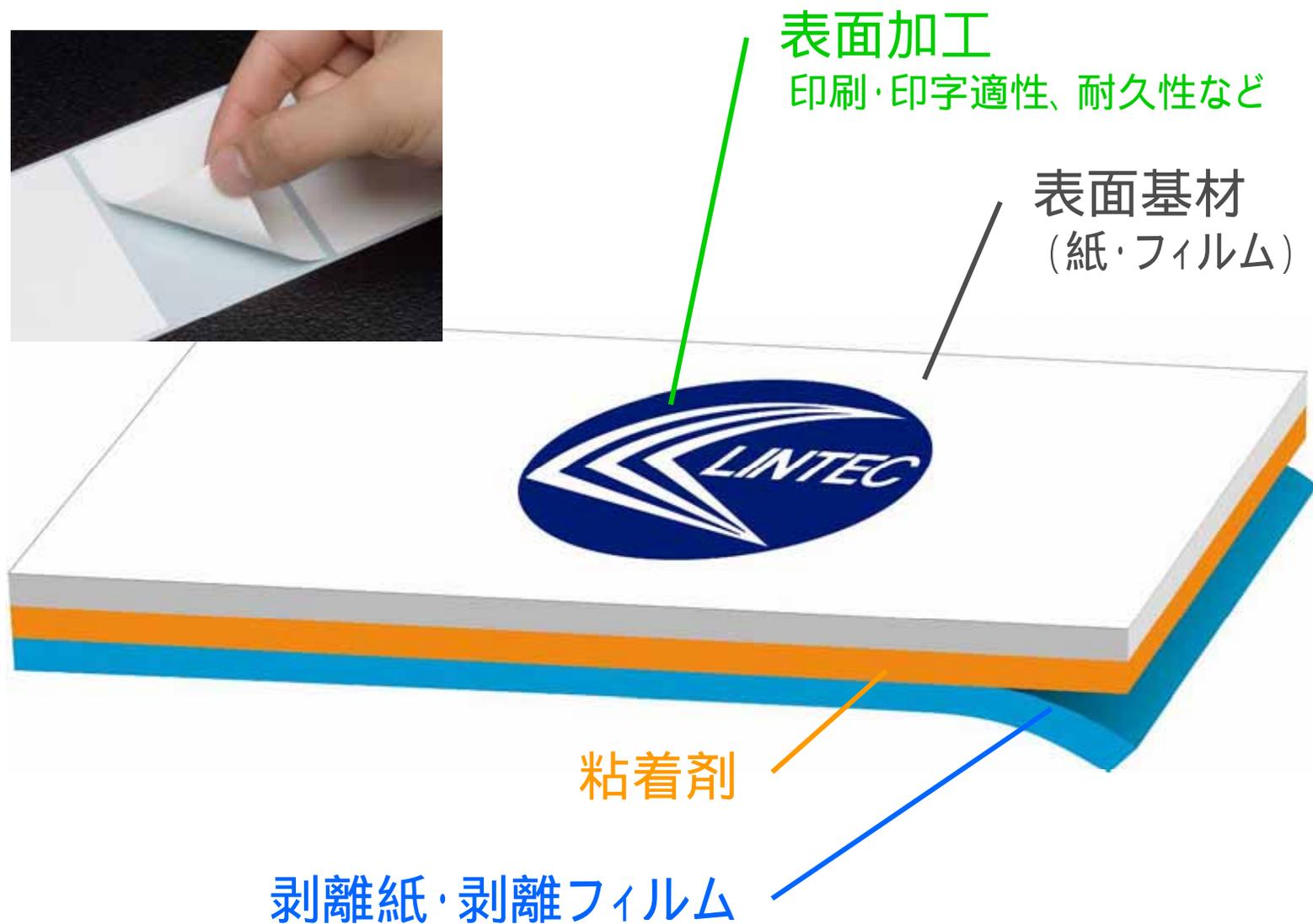
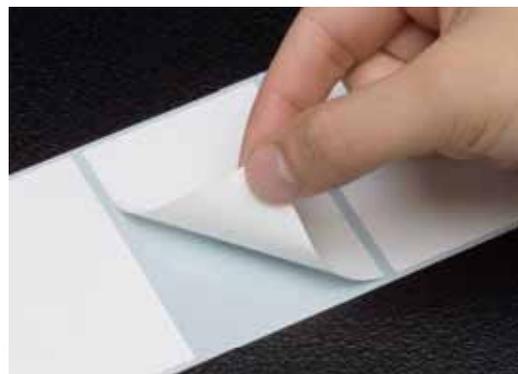


13.0%

海外売上高比率

33.2%

粘着製品の基本構成



四つの基盤技術と事業セグメント

基盤技術

1

粘着応用技術

2

表面加工技術

3

システム化技術

4

特殊紙製造技術

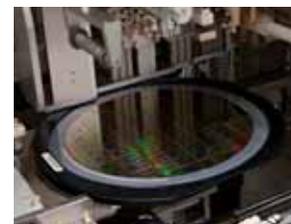
印刷材・産業工材関連

- ・印刷・情報材事業部門
- ・産業工材事業部門



電子・光学関連

- ・アドバンスドマテリアルズ事業部門
- ・オプティカル材事業部門

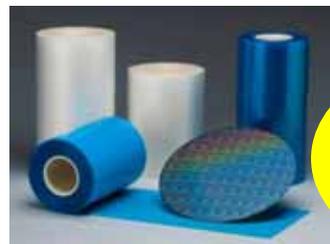


洋紙・加工材関連

- ・洋紙事業部門
- ・加工材事業部門



粘着素材
+
関連機器

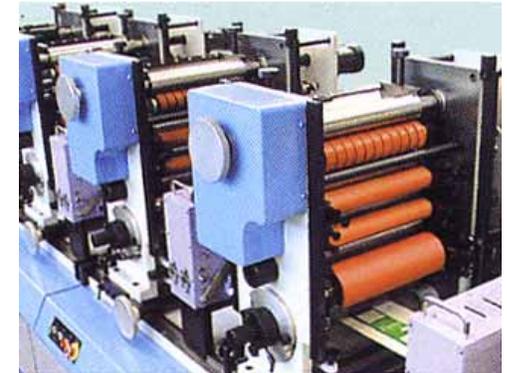
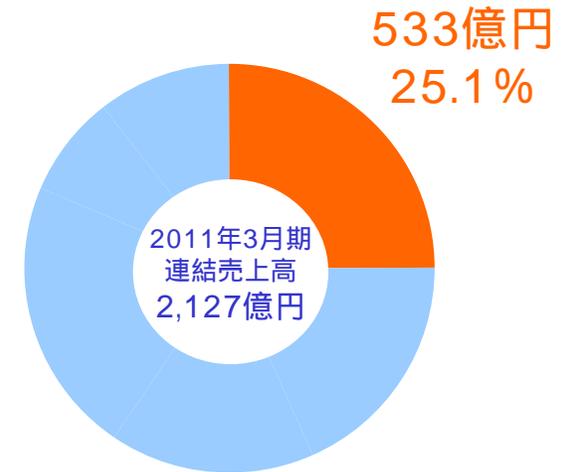


シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルム

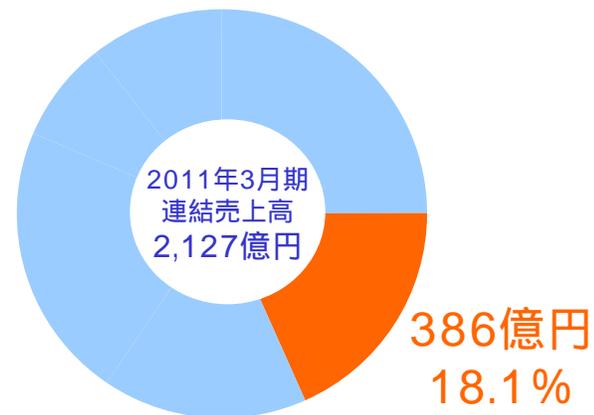
粘着剤によって、永久接着タイプ・再剥離タイプ・再貼付タイプに分けられる

印刷・印字適性、耐久性、耐熱性、耐水性、低温適性、曲面貼付性、寸法安定性、意匠性などに優れ、さまざまな用途や使用環境に対応

ラベル印刷機 など



屋外看板・広告用フィルム
内装用化粧シート
ウインドーフィルム
太陽電池用バックシート
自動車用粘着製品
工業用粘着テープ
ラベリングマシン など

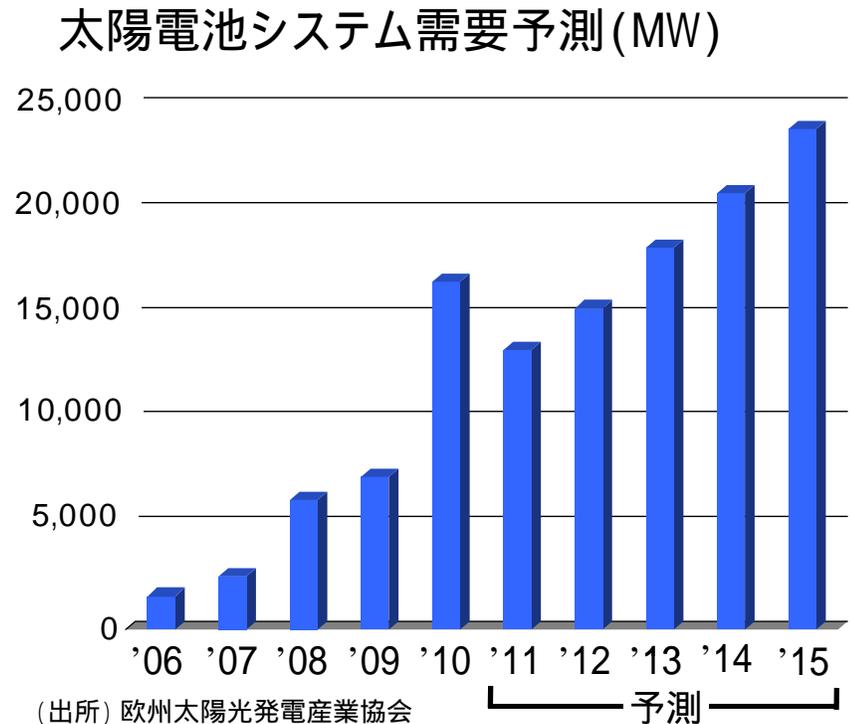
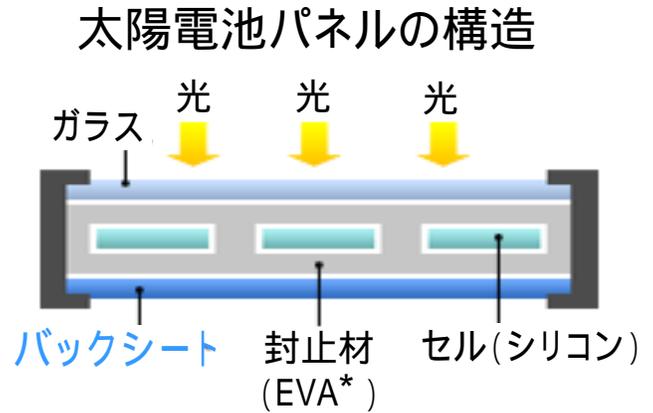


太陽電池用バックシート

- ・太陽電池パネルの裏面を保護するシート
- ・屋外使用への耐久性、発電効率向上のための高反射、電気絶縁性などが求められる
- ・地球温暖化対策として、各国で導入推進策が図られており、今後も大きな成長が期待される



*EVA = エチレン酢酸ビニル

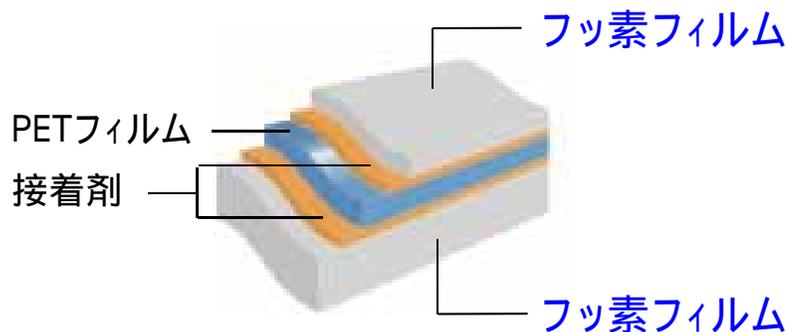


当社グループのバックシートの特徴

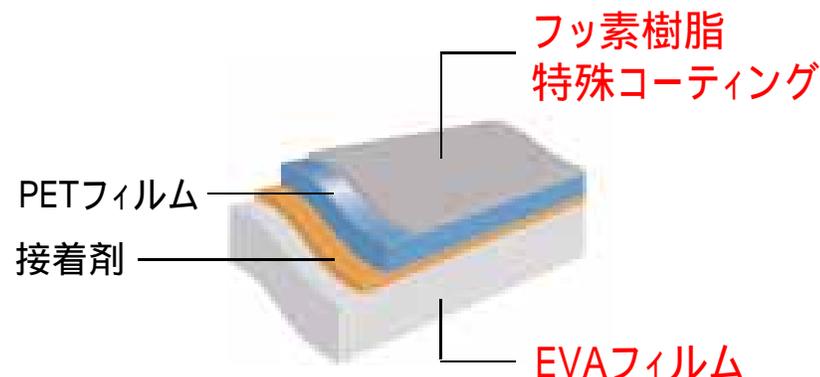
- ・一般的に使用されるフッ素フィルムに代え、フッ素樹脂のコーティングとEVAフィルムを採用
- ・耐久性、耐水性、電気絶縁性、封止材との接着性などに優れる
- ・価格競争力に優れ、安定供給も可能



(他社品)



(当社グループ製品)



当社グループのバックシート供給体制



- ・米国子会社のマディコ社で欧米向け、千葉工場と三島工場(愛媛県)で国内・アジア向けを製造
- ・バックシートの需要拡大に応じて、今後も生産能力の増強を図る

ドアサッシ用塗装代替フィルム



独自の材料設計によって、
空気を抜けやすくし、貼付を容易に

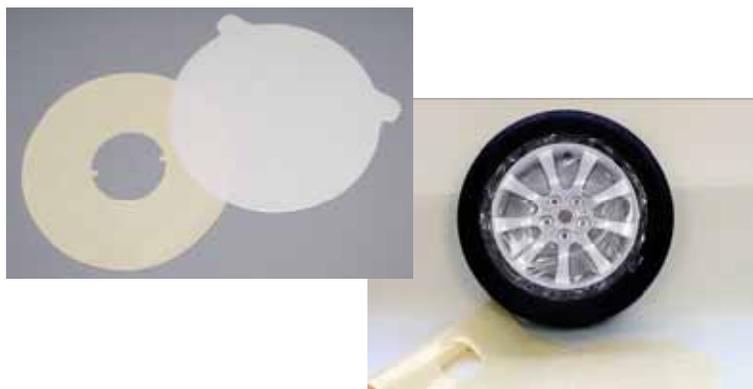


空気の入った状態



空気のない状態

アルミホイール用保護フィルム



マーキングフィルム ウインドーフィルム



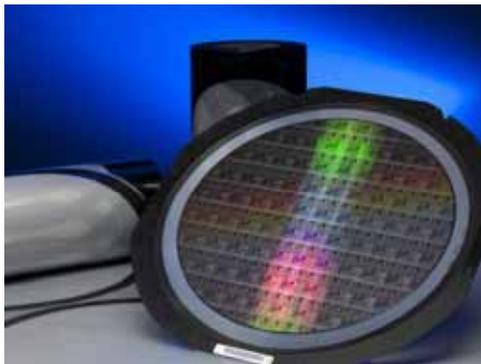
半導体関連テープ・関連装置

積層セラミックコンデンサー製造用

コートフィルム

タッチパネル関連製品

薄型テレビ用光学機能性フィルム など



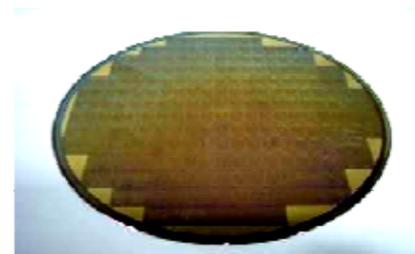
半導体チップの製造工程

【前工程】

単結晶シリコン
インゴット



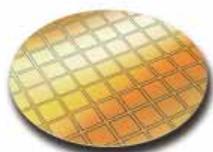
ウェハ



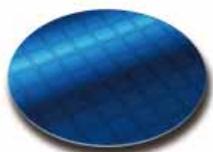
回路形成ウェハ

【後工程】

当社テープ・装置を使用



回路形成
ウェハ



表面保護
テープ貼付



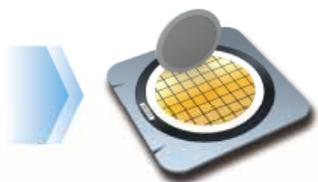
裏面研磨
(薄型化)



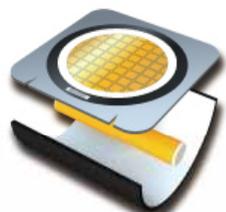
ダイシング
テープ貼付



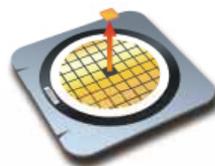
表面保護
テープ剥離



ダイシング
(ウェハ切断)



テープへの
紫外線照射



ピックアップ



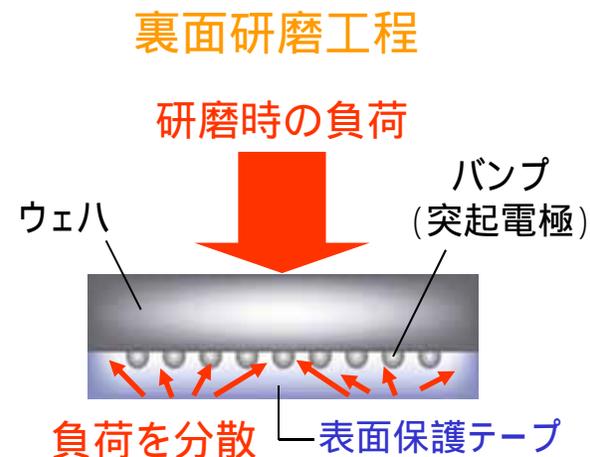
実装



樹脂封止

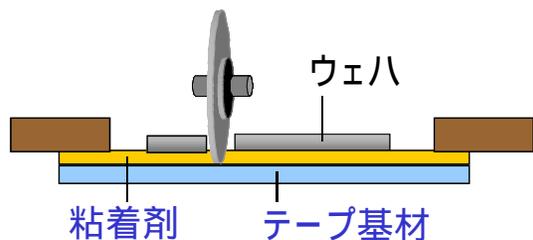
極薄・ハイバンプウェハ対応表面保護テープ

- ・特殊設計により、研磨後の薄型ウェハの反りを抑制
- ・回路面に形成されたバンプの凹凸にも、すき間なく貼ることができる、ウェハ表面の汚染を防止
- ・ウェハにかかる研磨時の負荷を分散して破損を抑制



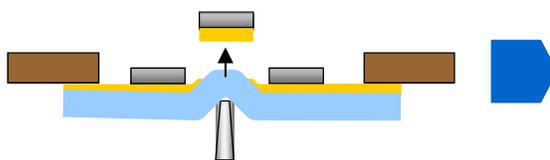
ダイシング・ダイボンディングテープ

ダイシング(切断)工程



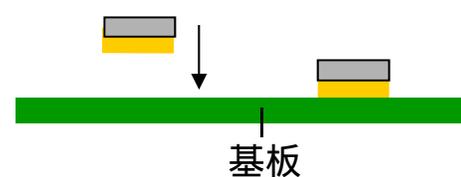
チップをしっかりと固定

ピックアップ工程



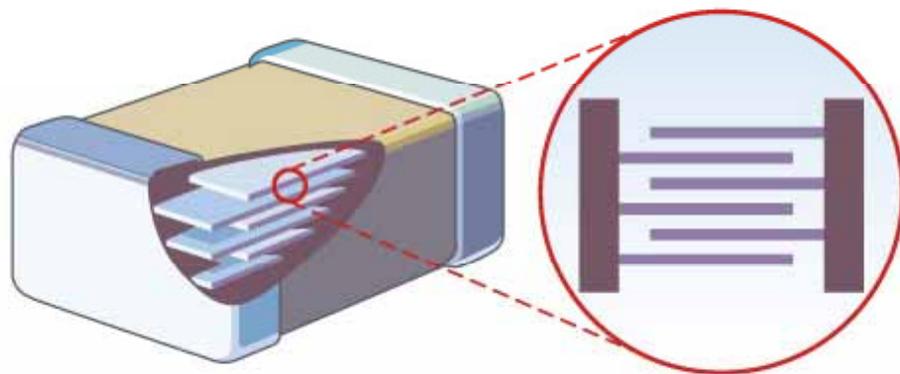
チップ裏面に粘着剤を転写

ダイボンディング(実装)工程

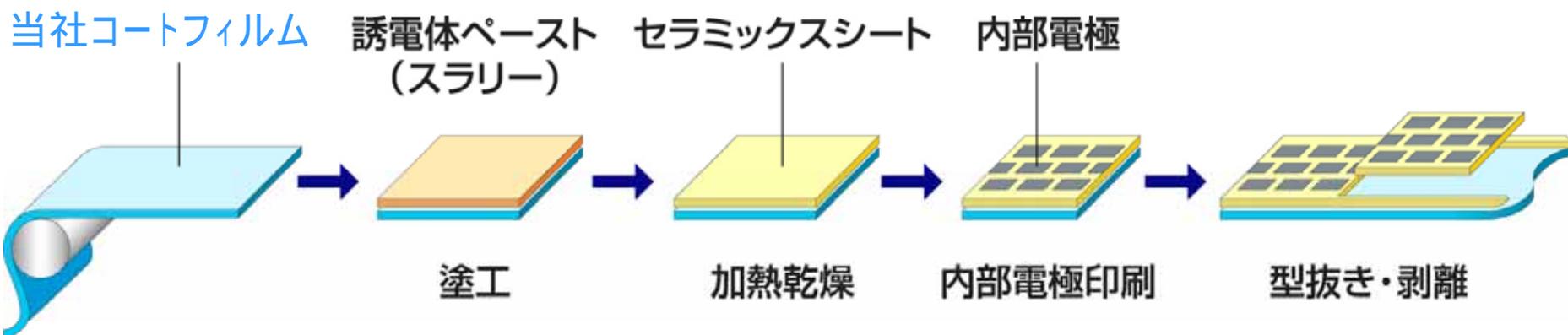


基板実装時の
接着剤塗布工程が不要に

積層セラミックコンデンサーの構造



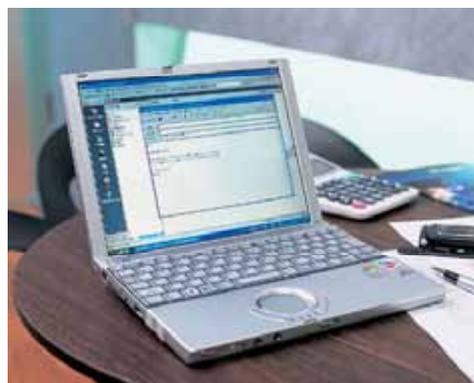
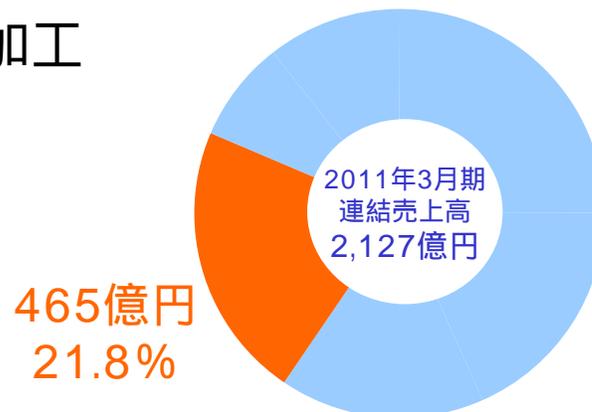
積層セラミックコンデンサーの製造工程



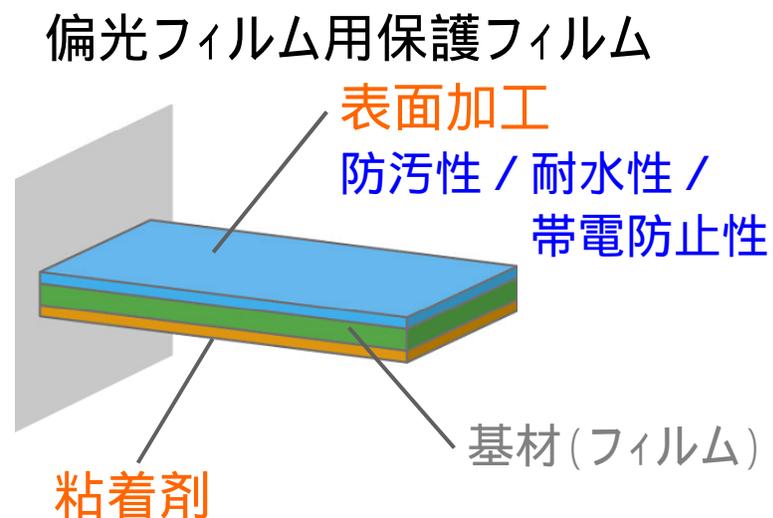
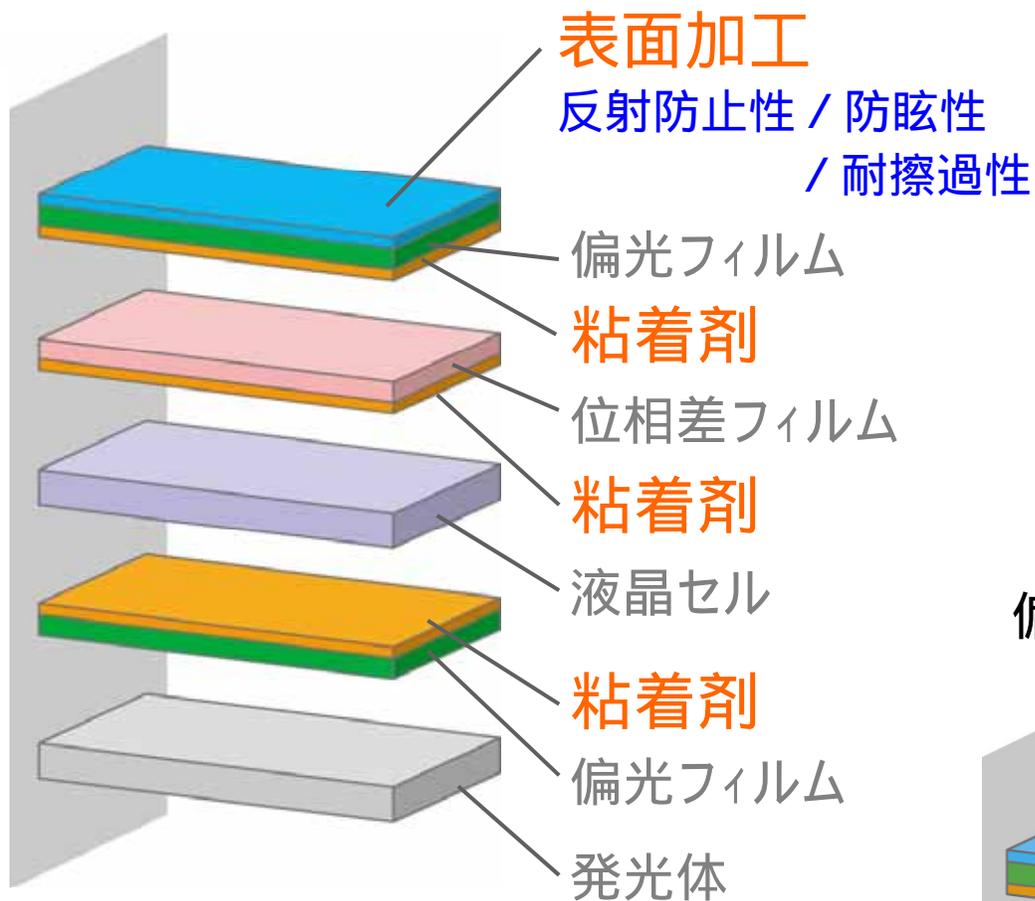
液晶用偏光・位相差フィルム / 粘着加工

液晶用偏光フィルム / 表面加工

偏光フィルム用保護フィルム など



液晶ディスプレイの構成



カラー封筒用紙

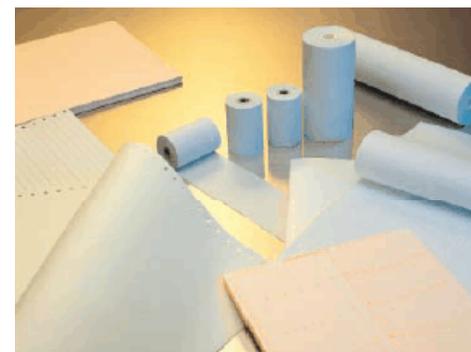
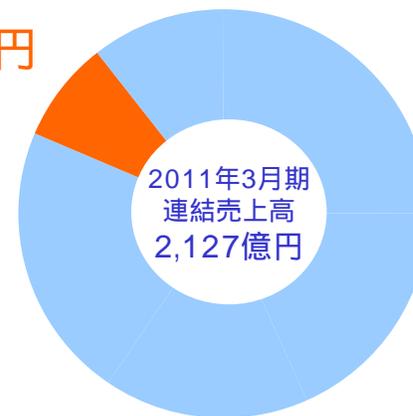
色画用紙

無塵紙

高級印刷用紙

高級紙製品用紙 など

175億円
8.2%



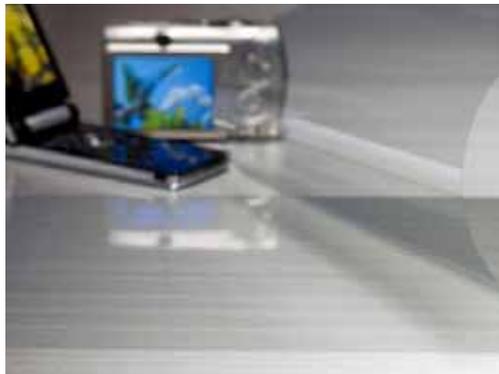
粘着製品用剥離紙・剥離フィルム

光学製品用剥離フィルム

FPC*カバーレイ用剥離紙

合成皮革用工程紙(剥離紙)

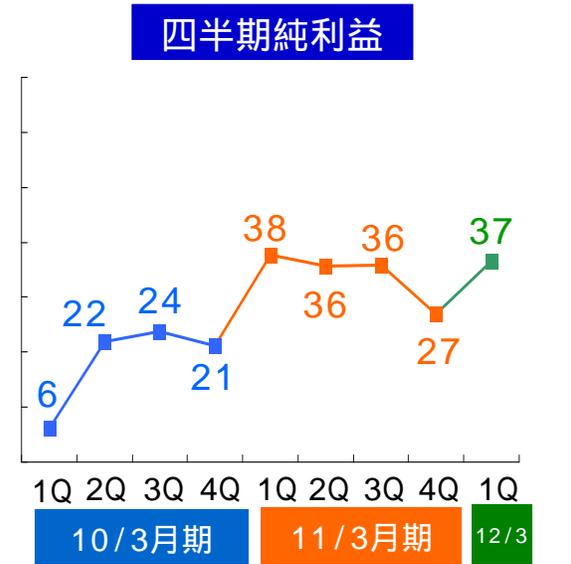
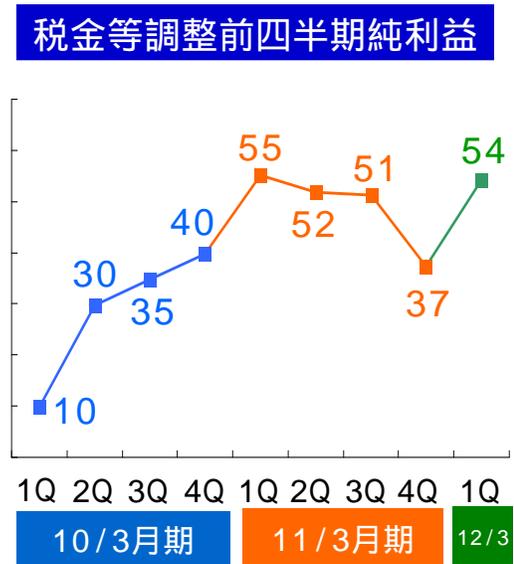
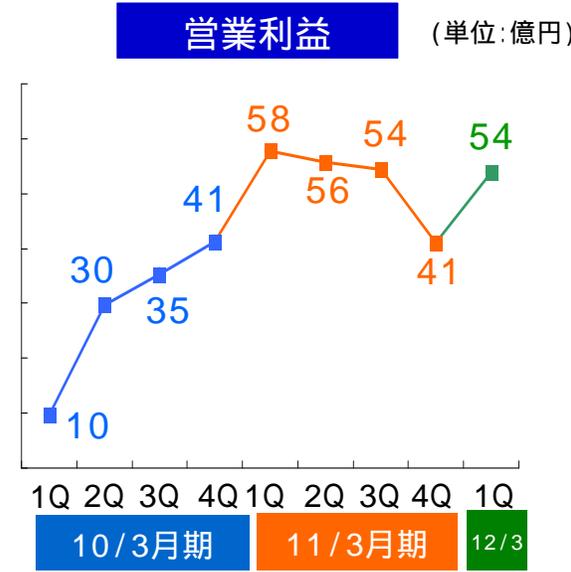
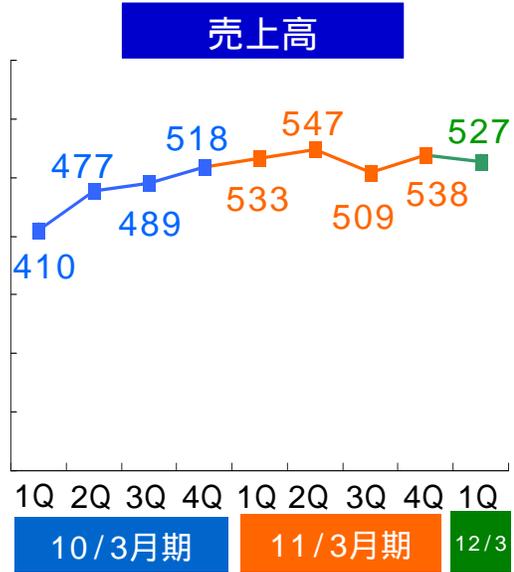
炭素繊維複合材料用工程紙(剥離紙) など



*FPC = フレキシブルプリント基板

2012年3月期第1四半期 連結業績の概要

	(単位: 億円)		
	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
売上高	527	533	6 (1.1%)
営業利益	54	58	4 (6.9%)
税金等調整前 四半期純利益	54	55	1 (1.8%)
四半期純利益	37	38	1 (2.6%)



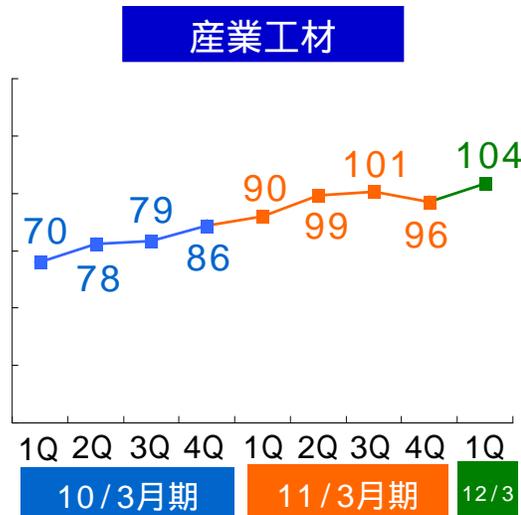
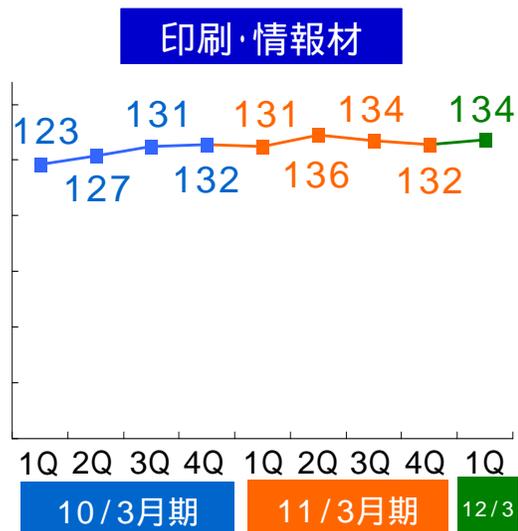
セグメント別売上高/営業利益 印刷材・産業工材関連

(単位:億円)

印刷材・ 産業工材 関連	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
印刷・情報材 事業部門	134	131	3 (2.3%)
産業工材 事業部門	104	90	14 (15.6%)
セグメント 売上高	238	221	17 (7.7%)
セグメント 営業利益	24	20	4 (20.0%)

事業部門別四半期売上高推移

(単位:億円)



セグメント別売上高/営業利益 電子・光学関連

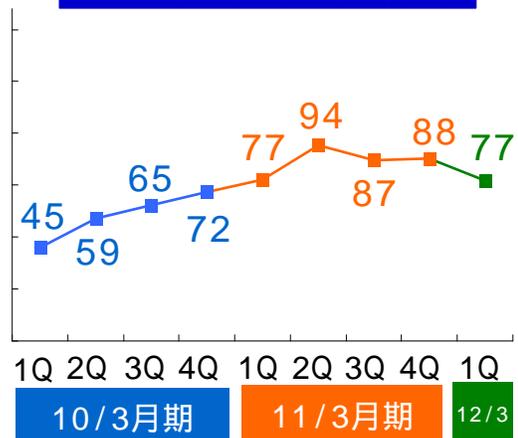
(単位:億円)

電子・光学 関連	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
アドバンス マテリアルズ 事業部門	77	77	0 (0.0%)
オプティカル材 事業部門	110	129	19 (14.7%)
セグメント 売上高	188	207	19 (9.2%)
セグメント 営業利益	13	17	4 (23.5%)

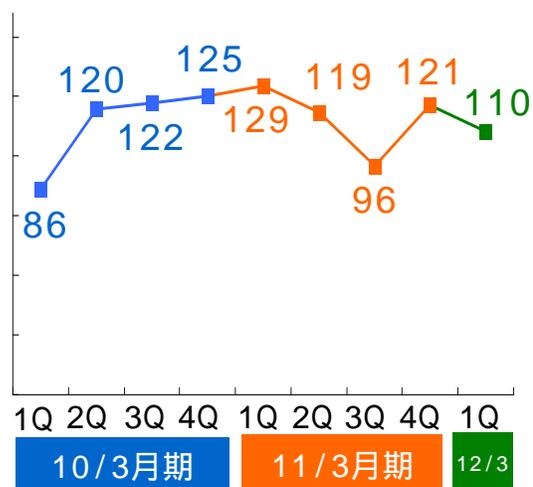
事業部門別四半期売上高推移

(単位:億円)

アドバンスマテリアルズ



オプティカル材



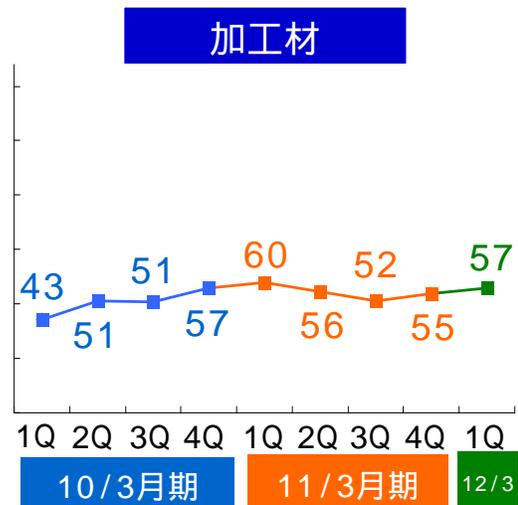
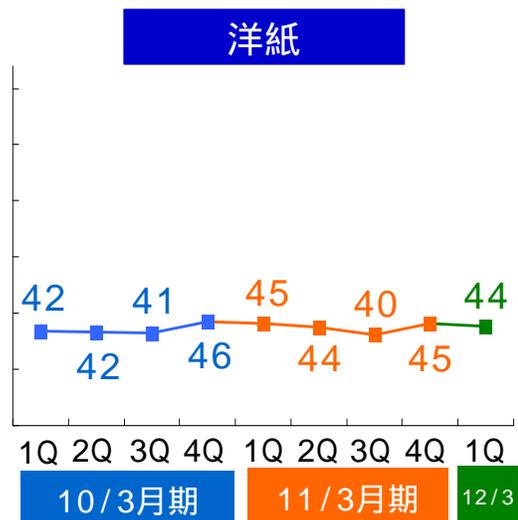
セグメント別売上高/営業利益 洋紙・加工材関連

(単位:億円)

洋紙・加工材 関連	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
洋紙 事業部門	44	45	1 (2.2%)
加工材 事業部門	57	60	3 (5.0%)
セグメント 売上高	101	105	4 (3.8%)
セグメント 営業利益	17	20	3 (15.0%)

事業部門別四半期売上高推移

(単位:億円)

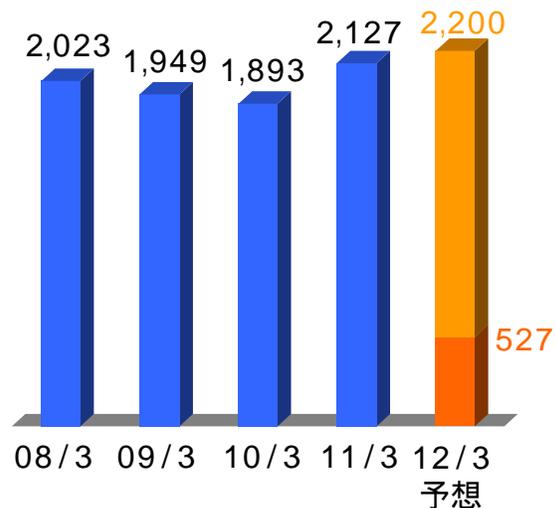


2012年3月期通期 連結業績の見通し

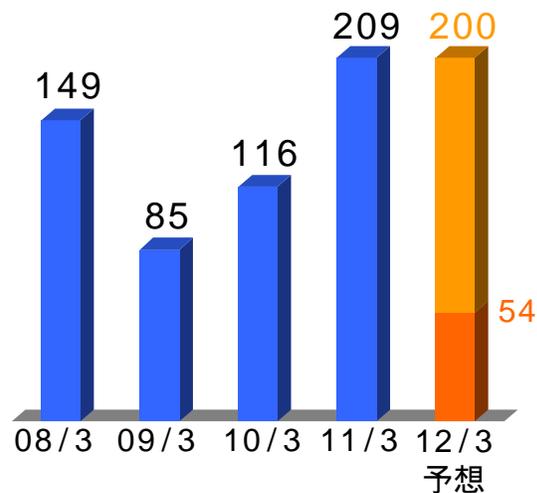
	12/3月期 通期予想	12/3月期 1Q実績	通期予想 に対する 進捗率	11/3月期 実績
売上高	2,200	527	24.0%	2,127
営業利益	200	54	27.0%	209
税金等 調整前 当期純利益	190	54	28.4%	196
当期純利益	131	37	28.2%	136

(単位:億円)

連結売上高 (単位:億円)



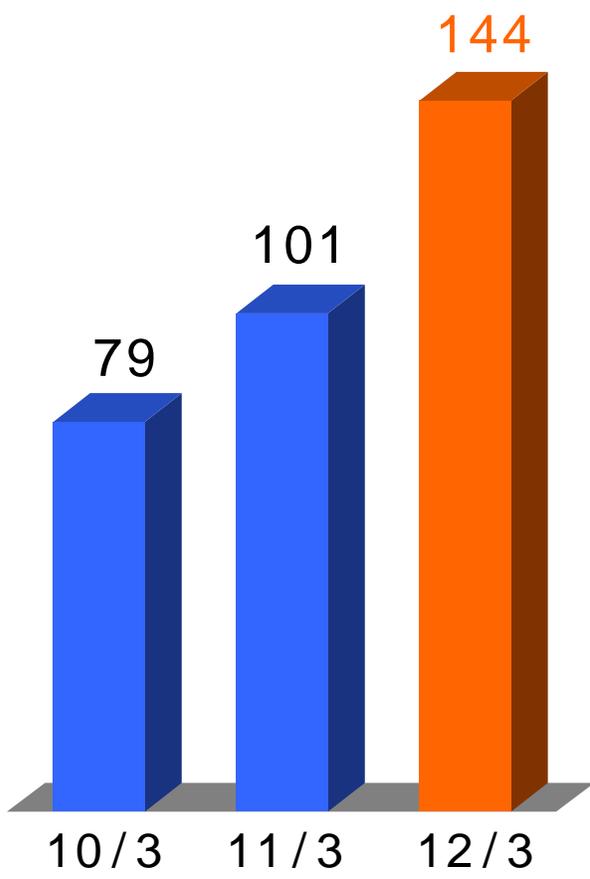
連結営業利益



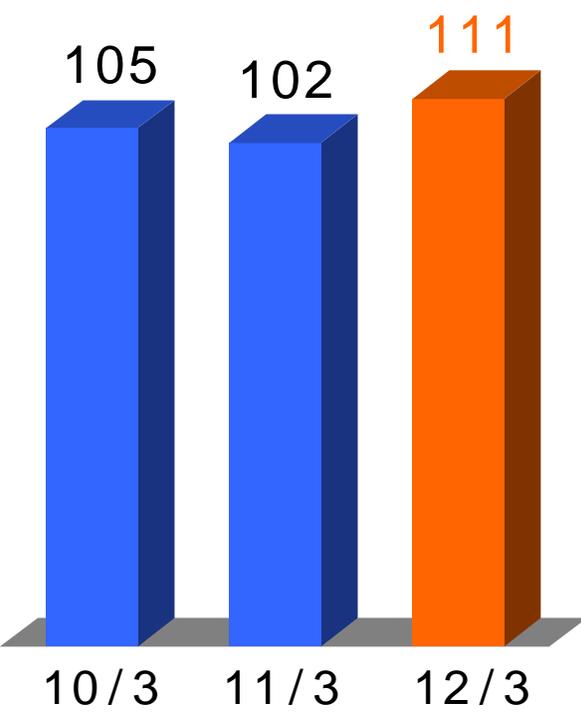
設備投資額・減価償却費・研究開発費

単位:億円 ■実績 ■見通し

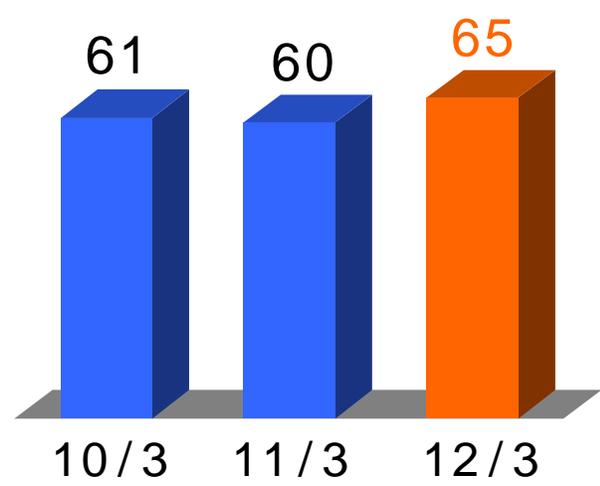
設備投資額



減価償却費



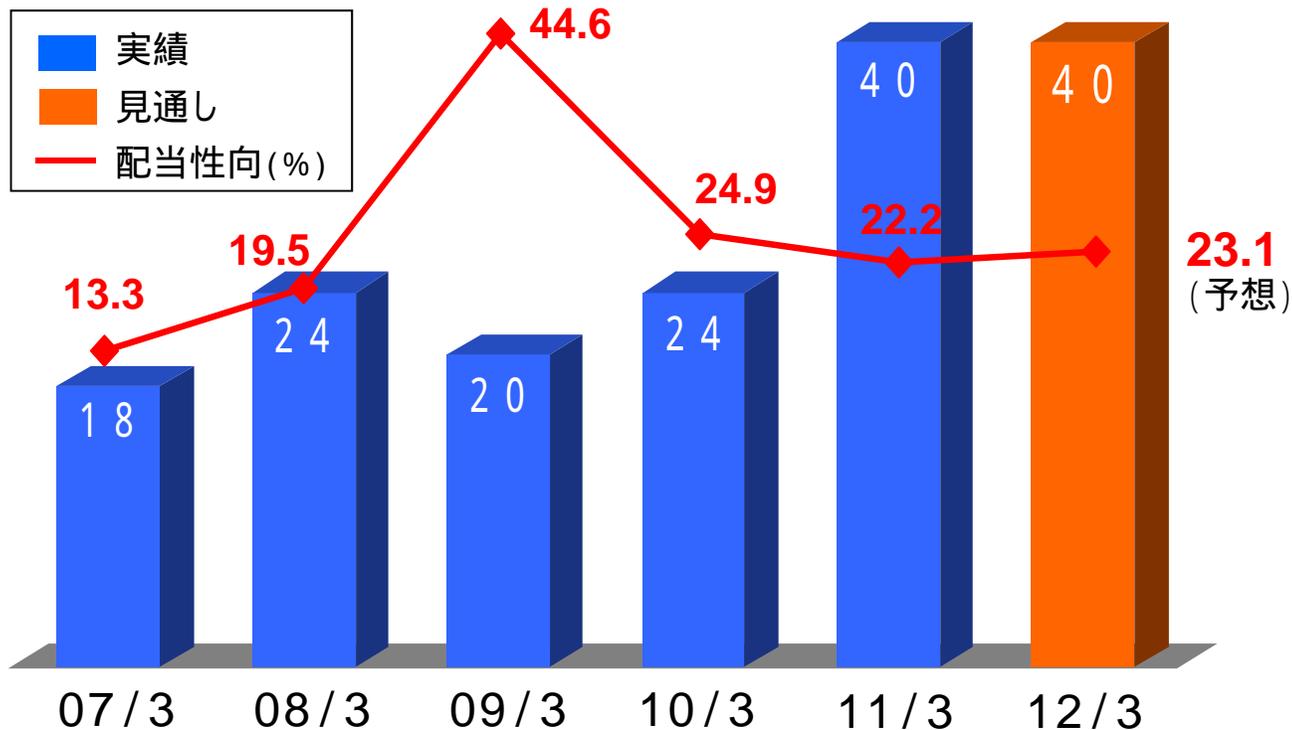
研究開発費



配当方針

長期的な視野に立った事業収益の拡大並びに財務体質の強化を図るとともに、連結業績を考慮した配当を実施

1株当たり配当金推移(円)



名 称 LIP - (LINTEC Innovation Plan)

期 間 2011年4月～2014年3月

基本方針 積極果敢にイノベーションに挑戦し、
持続的な成長と企業価値の最大化を目指す

重点テーマ

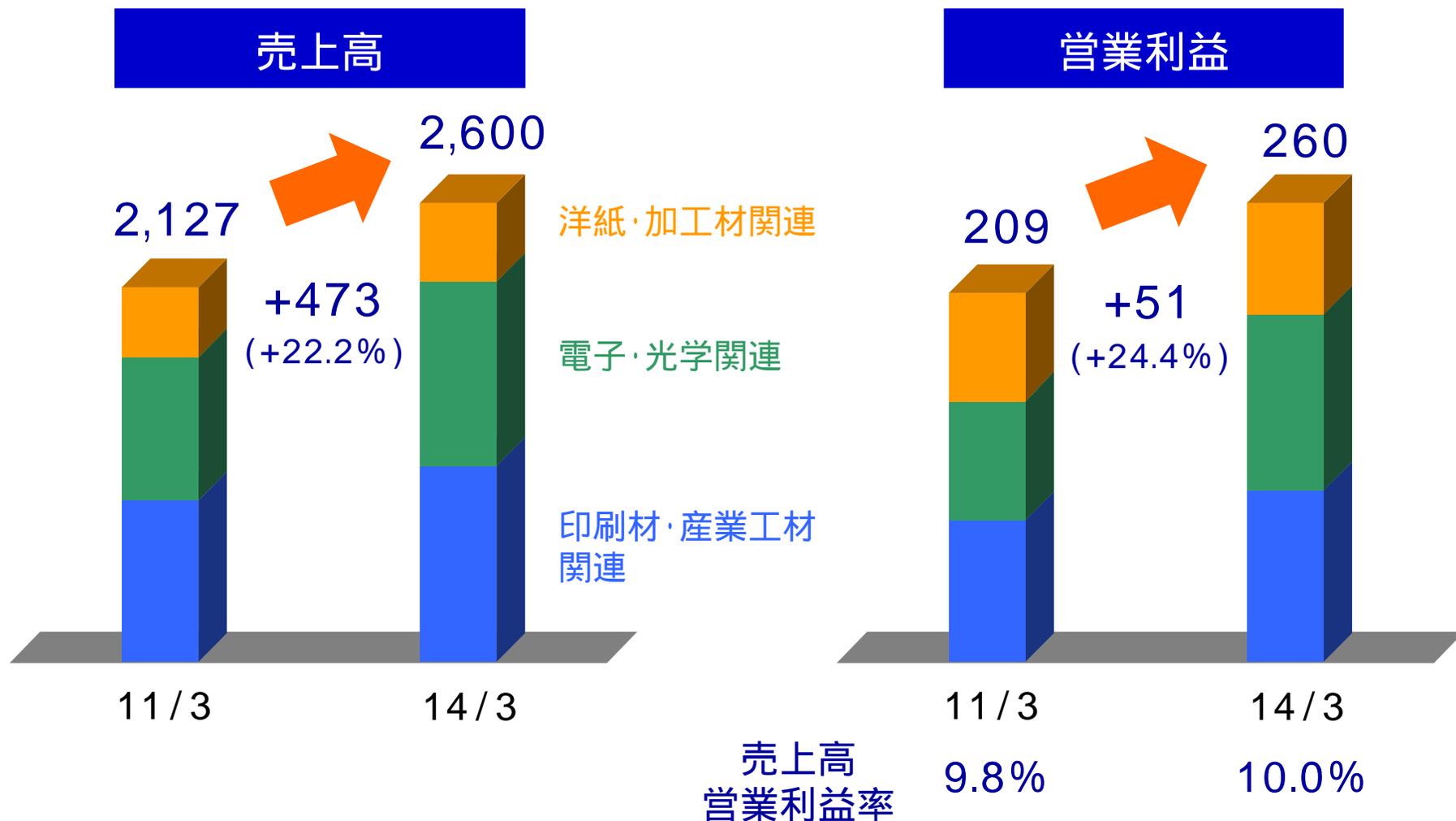
1. 海外事業の強化・拡大(海外売上高比率40%)
2. QCD強化による国内事業の拡大と高収益化
3. 次世代を担う独創的新製品の創出
4. グローバル経営の強化

最終年度の主要数値目標(連結ベース)

売上高	2,600億円	売上高営業利益率	10%以上
営業利益	260億円	ROE(自己資本利益率)	10%以上
純利益	170億円	ROIC(投下資本利益率)	10%以上

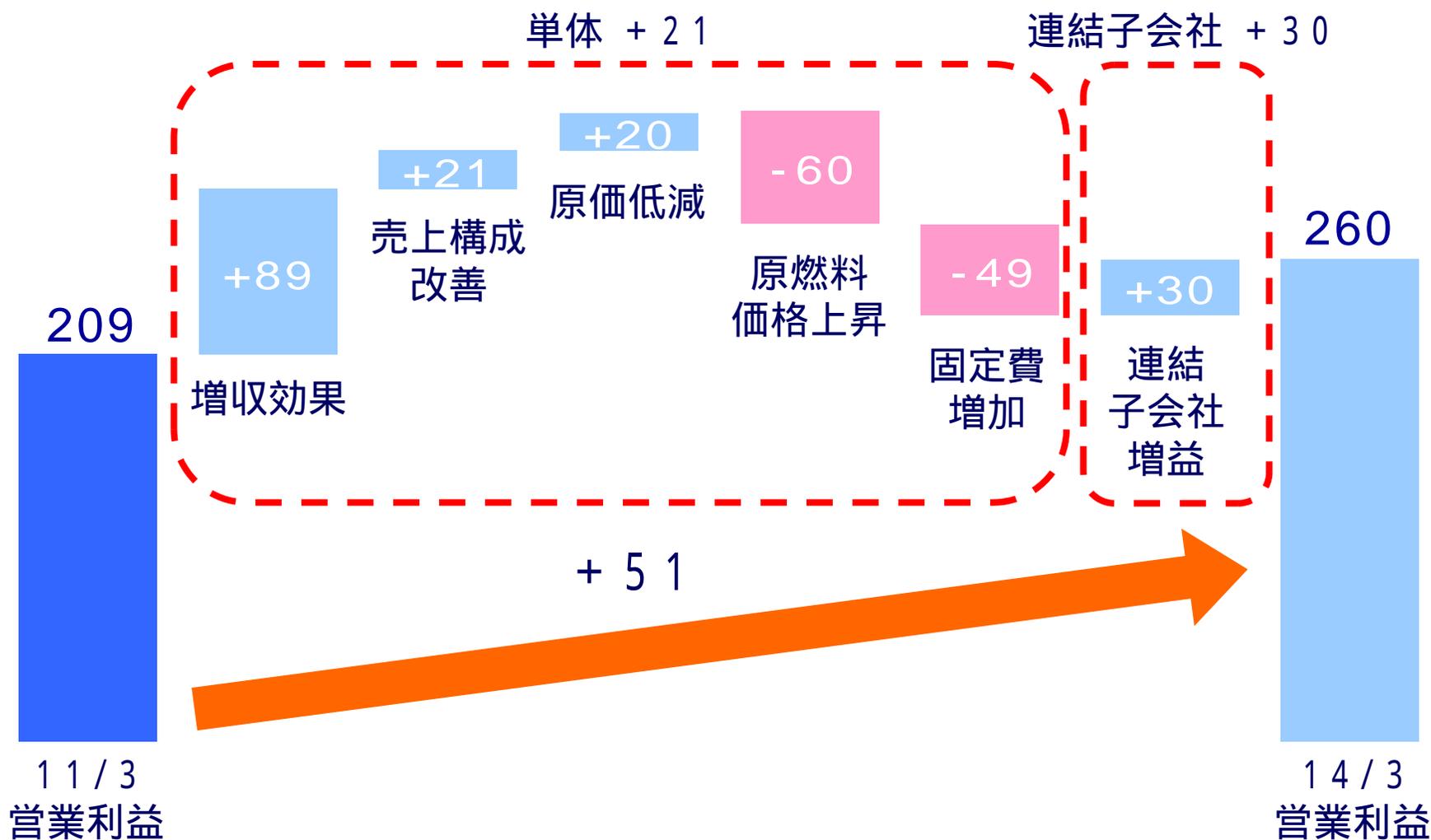
連結売上高・営業利益計画(最終年度 14/3)

(単位:億円)



(単位: 億円)

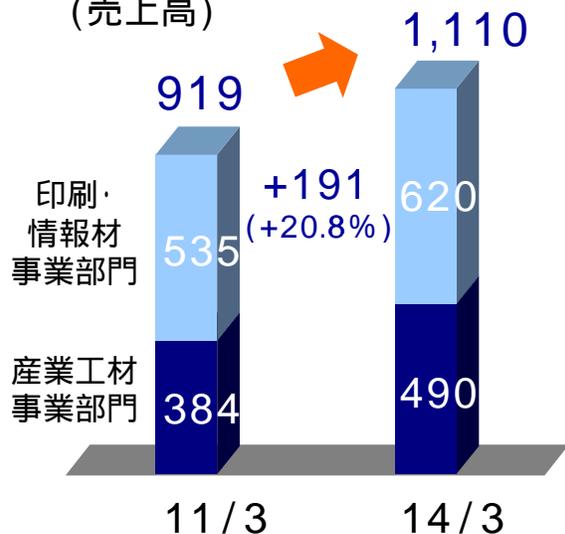
営業利益要因別増減



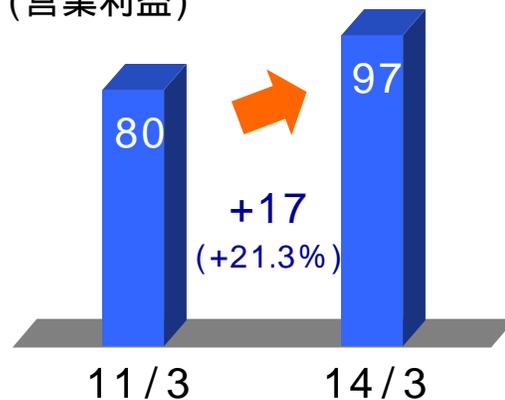
(単位: 億円)

印刷材・産業工材関連

(売上高)



(営業利益)

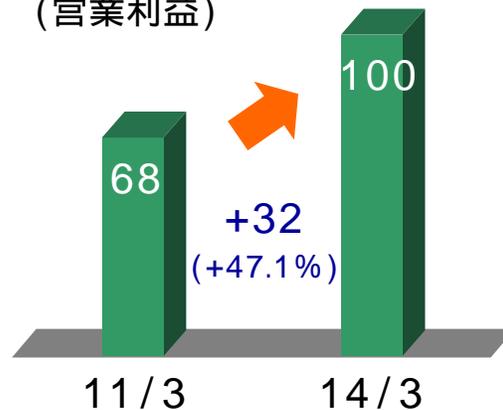


電子・光学関連

(売上高)

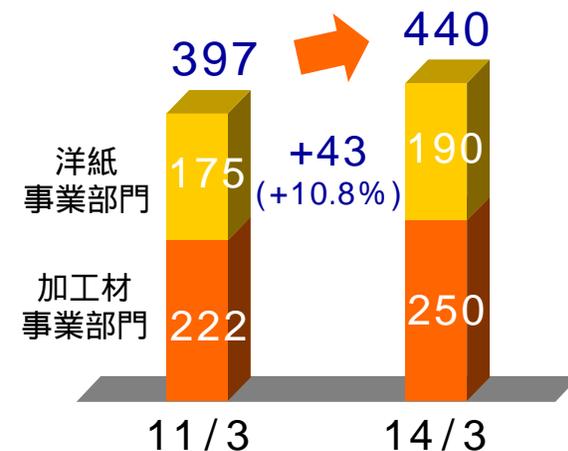


(営業利益)

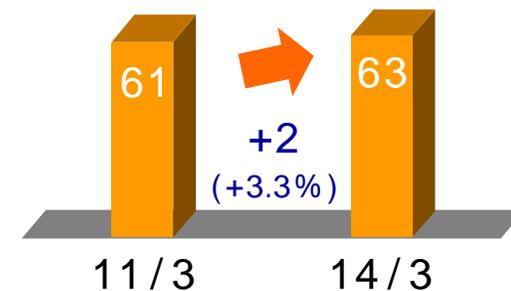


洋紙・加工材関連

(売上高)

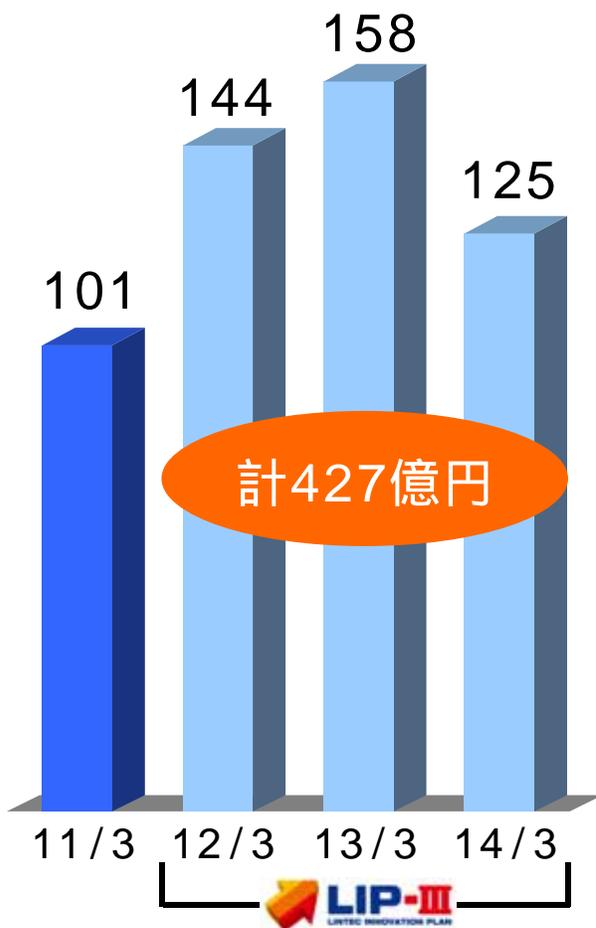


(営業利益)



単位:億円 ■実績 ■見通し

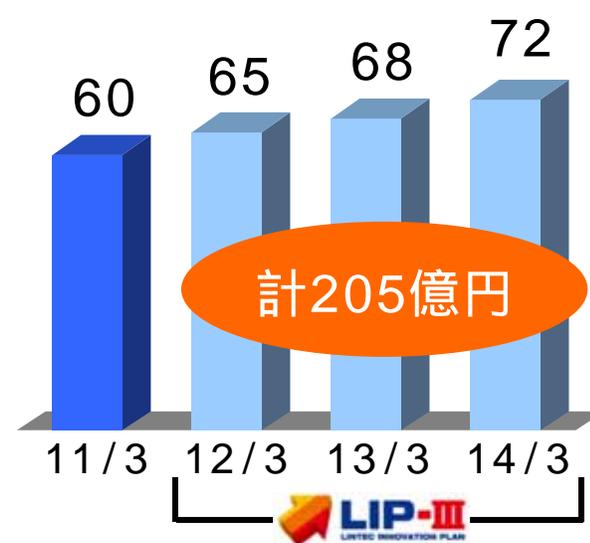
設備投資額



減価償却費



研究開発費



本資料および当社製品などに関するお問い合わせ先

リンテック株式会社 広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

TEL.03-5248-7741

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり、将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。したがって、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。